



Intel® Core™ i3-4170 Processor

3M Cache, 3.70 GHz

Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ i3 czwartej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Haswell poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Desktop
- Numer procesora i3-4170
- Stan Discontinued
- Data rozpoczęcia Q1'15
- Litografia 22 nm
- Rekomendowana cena klienta \$117.00

Wydajność

- Liczba rdzeni 2
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 3,70 GHz
- Cache 3 MB
- Szybkość magistrali 5 GT/s DMI2
- TDP 54 W

Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Nie
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 32 GB
- Rodzaje pamięci DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 25,6 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Tak

Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® HD Graphics 4400
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1,15 GHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 2 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4) ‡ 4096x2304@24Hz
- Maks. rozdzielczość (DP) ‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz) ‡ 3840x2160@60Hz

- Maks. rozdzielczość (VGA)‡ 1920x1200@60Hz
- Obsługa DirectX* 11.1/12
- Obsługa OpenGL* 4.3
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0x41E

Opcje rozszerzeń

- Skalowalność 1S Only
- Wersja PCI Express Up to 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Maksymalna liczba linii PCI Express 16

Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCLGA1150
- Maks. konfiguracja procesora 1
- Specyfikacja systemu Thermal Solution PCG 2013C
- T_{CASE} 72°C
- Wymiary obudowy 37.5mm x 37.5mm

Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost † Nie
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Nie
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Nie
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Nie
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Nie

Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Nie
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak